

# 有研半导体硅材料股份公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护有研半导体硅材料股份公司（以下简称“有研硅”“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，助力公司提升经营效率、加强市场竞争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。主要措施如下：

### 一、聚焦主责主业，提升企业核心竞争力

有研硅是国内最早从事半导体硅材料研制的单位之一，是国内为数不多的能够稳定量产8英寸半导体硅抛光片并生产区熔硅单晶的企业。在半个多世纪的发展历程中，公司突破了半导体硅材料制造领域的关键核心技术，积累了丰富的半导体硅材料研发和制造经验，在国内率先实现6英寸、8英寸硅片的产业化及12英寸硅片的技术突破，并实现集成电路刻蚀设备用硅材料产业化，有力保障并支持了国内集成电路产业的需求。公司拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等研发及创新平台，是集成电路关键材料国家工程研究中心主依托单位。

目前公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，现有山东德州和北京顺义两处国内一流的半导体硅材料生产基地，主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等，主要用于分立器件、功率器件、集成电路、刻蚀设备用硅部件等的制造，并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。公司产品同时出口美国、日本、韩国、中国台湾地区等多个国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力，获得了国内外主流半导体企业客户的认可。

2024年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术先进性，从而全面提升公司的核心竞争力和产品盈利能力。具体包括以下几个方面：

#### 1、坚持市场导向，以满足客户需求为一切工作出发点

公司坚持以客户为中心，以满足客户需要、为客户提供好的产品为一切工作的出发点。2024年公司将进一步加大市场开拓力度，在服务好老客户的同时，积极挖掘新

客户，加快推进新客户和新产品的认证工作，不断开拓市场，培育新的产品增长点。

## **2、坚持提质增效，加强成本管控，提高单位效能**

公司将持续开展管理提升、降本增效工作，不断提高全成本管控能力。2024年将  
继续推进技术创新、工艺改进提升产品合格率，降低原辅材料消耗，推进原辅材料、  
备品备件国产化工作，增强产业链上下游合作，提升供应链的保障能力和安全性。

## **3、坚持围绕主业，积极推进募投项目建设**

公司将积极推动集成电路用8英寸硅片扩产项目和集成电路刻蚀设备用硅材料项目  
两个募投项目的实施，尽快实现产能释放。适时启动第二个5万片8英寸硅片的扩产计  
划，不断优化产品结构，丰富产品层次，扩大产业规模。

# **二、提升科技创新能力，重视人才培养**

## **1、提升科技创新能力**

公司高度重视科技创新，建立了运行有效的研发体系，以用户需求为导向，积极推  
进研发技术产业化和市场应用。公司拥有独立完整的自主研发体系，核心技术研发由公  
司技术研发团队独立完成，并形成了具有自主知识产权的专利布局。2023年，公司通过  
了北京市“专精特新”中小企业等资质认定，控股子公司山东有研半导体材料有限公司  
（以下简称“山东有研半导体”）通过国家专精特新“小巨人”企业认定；获批山东省  
企业技术中心等。

2024年，公司将继续坚持对标全球领先技术、对标行业领先企业，以技术升级与  
创新驱动产品性能及品质提升，不断优化产品性能和客户体验，促进创新的实施和推  
广巩固公司产品技术领先优势。

## **2、加快新品研发**

2023年，公司在核心技术基础上，持续研发新产品，培育新的增长点。研发出8英  
寸区熔片、8英寸MCZ超低氧单晶及硅片、8英寸红磷超低阻单晶及硅片、超大直径单晶  
等新产品，单位效能不断提高。

2024年，公司将继续坚持创新驱动发展战略，加快新产品、新技术研发力度，通  
过不断的研发投入推动技术的持续改进和创新，实现硅材料技术与集成电路工艺的同步  
升级迭代。公司将通过自主研发、合作研发等方式，不断研发新产品和新工艺，进一  
步掌握关键核心技术、提升研发能力，努力提高高附加值、高技术产品的比例，推  
进新产品的市场应用，加快新产品认证，丰富产品种类，保持持续盈利能力。

### 3、重视人才培养

在人才培养方面，公司将继续加强校企合作，与清华大学、大连理工大学、北京科技大学、山东大学等开展广泛深入的技术交流，推进工程硕士、工程博士的联合培养，拓宽人才培养渠道，为公司发展提供强有力人才支撑。

不断完善人力资源管理和激励体系，多措并举优化人才政策，着力打造“科技骨干人才、优秀经管人才和专业技术人才”矩阵，搭建管理、技术、操作三序列职业发展通道。加大对优秀年轻人员的选育力度，持续推进“内训师计划”，实施“师徒制”，为企业发展储备中长期发展人才。实施股权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效激励优秀人才。

### 三、优化财务管理，提高资金使用效率

公司高度重视财务管理工作，不断提高经营管理效率与盈利质量。

#### 1、提高盈利水平

2023年，公司持续开展提质增效活动，硅片产品保持了较高的开工率，全年毛利率为34.16%，净利率为30.01%。

2024年，公司将继续加大新产品研发力度，进行工艺改进，提高生产效率，从而降低成本，提高产品竞争力。加大市场拓展力度，适应行业形势，紧跟半导体行业发展的步伐。加快新产品研发，积极开拓新客户，努力提高公司的市场占有率，提升公司的盈利水平。

#### 2、提升运营效率

2022及2023年度，公司应收账款余额分别为1.51亿元、1.70亿元，应收账款周转率分别为1.83、1.49；存货余额分别为2.80亿元、2.06亿元，存货周转率分别为0.79、0.65。

2024年，公司将优化信用政策、建立良好的催收流程，做好订单回款收款管理工作，以提高应收账款周转率；对于存货周转方面，公司将不断提高库存管理水平，加快新产品在客户端的认证，实现降库存并贡献现金流，提高流动资产运营效率。

#### 3、提高资金效率

近年来公司保持较稳定的盈利水平，经营性现金流健康。为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高的现金和短期金融产品储备，至2023年末，本公司的货币资金余额为15.04亿元，交易性金融资产余额为13.52亿元。

2024年，在保障公司经营安全的前提下，公司将继续通过以下方式，提高资金的收益：（1）投资安全性较高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的金融产品；（2）以现金分红或股份回购的形式，将公司的一部分盈余回报给股东；（3）积极寻求上下游企业投资机会，在审慎决策的前提下，扩大产业链条，优化企业资源配置，不断提高资金回报。

#### **四、不断完善公司治理和规范运作**

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

##### **1、严格落实独董制度**

根据中国证券监督管理委员会2023年8月颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司紧跟监管政策、积极响应，于2023年12月完成了《公司章程》《独立董事工作制度》等9项管理制度的修订及制定。2024年，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，保障在任独立董事均符合法律法规规定的任职资格与条件，充分发挥独立董事作用。根据修订后的《公司章程》及各专门委员会议事规则，优化审计机构选聘程序，探索制定审计机构选聘制度。

##### **2、压实各委员会职责**

公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，建立了相应的工作制度或工作细则，按照工作规则履行职责，为董事会科学决策提供依据。2024年，公司将加强董事会各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

##### **3、完善内控制度**

公司根据实际情况制定了《内部控制基本规范》，2024年公司进一步全面梳理现有公司规章制度，继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制制度，提高内部控制管理水平，加强内部控制监督检查，增强内部控制执行效果，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康持续发展。

##### **4、积极组织董监高培训**

公司董监高积极参加证监会、上交所、中上协等监管平台举办的线上、线下专项培训，加强对证券市场最新法律法规的学习，不断提升其履职技能和合规知识储备，推动公司治理水平的全面提升。未来公司亦将按照有关法律法规的要求，支持董监高积极参与相关培训。

## **五、提升信披质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，2024年，公司仍将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。继续严谨、合规地开展信息披露工作，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文、视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况，为股东提供准确的投资决策依据。继续发布环境、社会和治理（ESG）社会责任报告，向投资者展示公司的财务状况和业务运营情况，与投资者建立更加紧密的联系，同时彰显公司在可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。

在投资者交流方面，公司将进一步构建多渠道、多平台、多方式的投资者关系管理。通过投资者热线电话、公开邮箱、上证e互动、业绩说明会、现场调研等多种线上、线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、回应投资者诉求。2024年公司计划开展线上业绩说明会不少于4次，投资者交流会不少于2次，根据机构调研的需求适度开展线下交流。

## **六、共享发展成果，注重投资者回报**

公司综合考虑投资者回报需求、盈利水平、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了合理的利润分配方案，与全体股东共享公司发展红利。公司已于2023年9月实施完成2023年半年度权益分派，以总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利74,857,263.48元（含税）。2023年末公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计拟派发现金红利12,476,210.58元（含税）。全年累计派发现金红利87,333,474.06元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的34.36%。

2024年，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对

公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会审议批准，公司将回购股份资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）。目前公司正在积极推进回购事宜，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

2024年，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大股东共享行业及公司发展成果。公司将根据整体发展战略与目标规划，紧密围绕半导体产业链，加强市场调研，努力推动已布局项目尽快达产实现盈利。不断培育新的增长点，拓展新的业务领域，提升企业竞争能力和抗风险能力，保障公司健康可持续发展。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束及“关键少数”的责任

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司董事长、实际控制人方永义先生承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，承诺在锁定期届满后2年内本人减持本人持有的发行人上市前股份的，减持价格不低于有研硅首次公开发行股票的发行价，未来也将严格履行承诺，与股东利益共担。

2024年，公司将继续完善企业管理，不断改进薪酬及绩效体系，结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬调整、支付、分配与公司业绩经营相挂钩。董事会薪酬和考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，有利于激发管理层的积极性和创造性，保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

## 八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年3月27日